

ANSPRECHPARTNER / KONTAKTE:

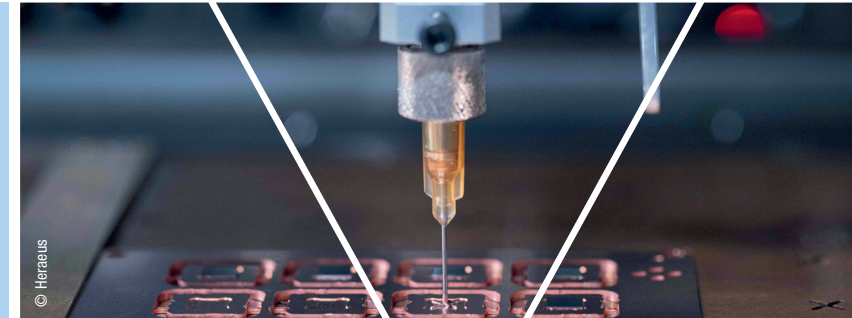
Philipp Loermann, Geschäftsführung der AG

Sebastian Fritzsche, Obmann der AG

Christoph Üffing, Stellv. Obmann der AG



Unsere Mitglieder bilden die starke Basis –
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte
Verfahren e.V.



NETZWERK:

FA 10 Mikroverbindungstechnik,

DVS Forschung



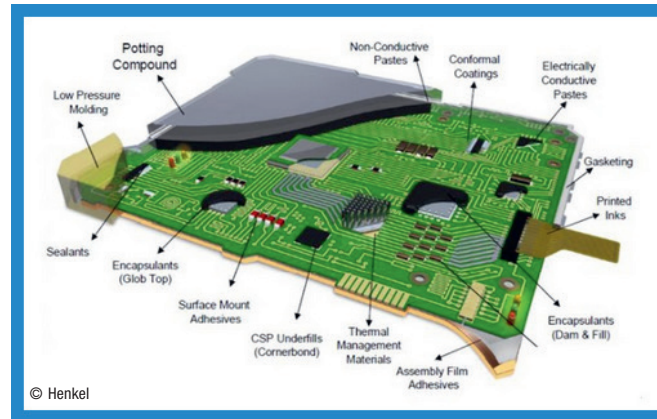
FA 08 Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik,

DVS Forschung



NA 092-00-28 AA Klebtechnik (DVS AG V 8),

DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte
Verfahren e. V. – Ausschuss für Technik



Forschung und Technik in der AG A 2.7

Kleben und Sintern in Elektronik
und Feinwerktechnik

Philipp Loermann

Geschäftsführung der AG

P +49. (0)2 11. 15 91-117

F +49. (0)2 11. 15 91-200

philipp.loermann@dvs-hg.de

DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.

Aachener Straße 172

40223 Düsseldorf

www.dvs-home.de

www.dvs-home.de

DER VERBAND

Der DVS ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband, der sich mit fast 120 Jahren Erfahrung umfassend für die Fügetechnik engagiert. Anders gesagt: Im DVS dreht sich alles um das Fügen, Trennen und Beschichten von metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen und Werkstoffverbunden. Ziel aller DVS-Aktivitäten ist es, die Fügetechnik umfassend zu fördern. Dies geschieht auf unterschiedlichste Art und Weise. Der DVS initiiert und begleitet Forschungs-aktivitäten, er erfasst den aktuellen Stand der Technik, schreibt diesen kontinuierlich fort und sorgt dafür, dass auch die DVS-Aus- und Weiterbildungsangebote den jeweils neuesten Wissensstand aus Technik und Forschung widerspiegeln. Dieses enge Netzwerk aus Forschung, Technik und Bildung ist das Kernelement der technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit im DVS.

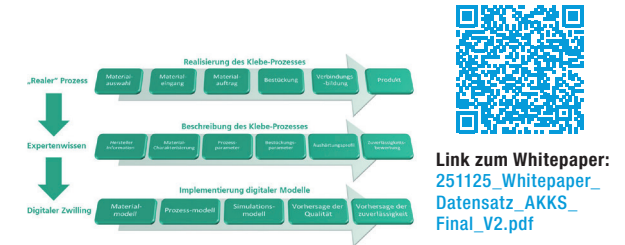
FORSCHUNG UND TECHNIK IN DER AG A 2.7 KLEBEN UND SINTERN IN ELEKTRONIK UND FEINWERKTECHNIK

Die AG A2.7 beschäftigt sich mit allen Aspekten des Einsatzes der Verbindungsverfahren Kleben und Niedertemperatur-Sintern in der Mikrofertigung. Die gegenwärtigen Aktivitäten reichen von der Ermittlung anwendungsrelevanter Werkstoffdaten über die Vereinheitlichung von Datenblättern sowie fertigungstechnische Fragestellungen wie z.B. geeigneten Auftragsverfahren und Prozesskontrollen bis hin zu Gebrauchseigenschaften von Fügeverbindungen und Mikroverbindungstechnik und deren Zuverlässigkeit. In diesem Zusammenhang kommt der Ermittlung des aktuellen und zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsbedarfs eine zentrale Bedeutung zu.

Die AG A2.7 ist eine interdisziplinäre Gruppe, dessen Experten aus unterschiedlichen Branchen miteinander zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit erfolgt meist in Verbindung mit Unternehmensbesuchen der Gruppenmitglieder und sorgt so für interessante Einblicke in verschiedene Anwendungs- und Produktbereiche. Die Arbeitsgruppe legt außerdem Wert auf informative Fachvorträge, um die Treffen neben der Arbeit an fachlichen Themen zu einem interessanten Gesamtpaket für alle Teilnehmer zu machen.

Zurzeit setzt sich das Gremium aus über 60 Experten der Industrie und Forschung zusammen.

Die Arbeitsgruppe hat unter anderem ein Whitepaper zur „Zukunft des Datensatzes“ erstellt und beschreibt somit auch die Bedürfnisse der Branche:



MITGLIEDER

Die über 60 Mitglieder der AG 2.7 kommen aus der Material- und Prozess-Entwicklung sowie von Anwendern für Kleber- und Niedertemperatur-Sinter-Applikationen mit industriellen und akademischen Hintergrund in der Elektronik und Feinwerktechnik.

